



## 2023年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2022年8月10日

上場会社名 株式会社 岡本工作機械製作所

上場取引所 東

コード番号 6125 URL <https://www.okamoto.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 石井 常路

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員 管理本部長 (氏名) 高橋 正弥

TEL 027-385-5800

四半期報告書提出予定日 2022年8月12日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2023年3月期第1四半期の連結業績(2022年4月1日～2022年6月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年3月期第1四半期	10,070	26.6	1,080	138.5	1,154	135.2	836	277.1
2022年3月期第1四半期	7,954		452		490		221	

(注) 包括利益 2023年3月期第1四半期 1,566百万円 ( %) 2022年3月期第1四半期 118百万円 ( %)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年3月期第1四半期	183.38	182.77
2022年3月期第1四半期	55.43	

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を前第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2022年3月期第1四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっており、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2023年3月期第1四半期	49,574	21,736	43.8
2022年3月期	47,507	20,331	42.8

(参考) 自己資本 2023年3月期第1四半期 21,730百万円 2022年3月期 20,321百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年3月期		60.00		80.00	140.00
2023年3月期					
2023年3月期(予想)		80.00		80.00	160.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日～2023年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	21,000	22.2	2,300	55.0	2,250	40.9	1,600	35.8	352.02
通期	43,000	14.5	4,800	17.6	4,700	12.0	3,200	10.6	704.04

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

#### 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- |                    |     |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更         | : 無 |
| 会計上の見積りの変更         | : 無 |
| 修正再表示              | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2023年3月期1Q	4,717,895 株	2022年3月期	4,717,895 株
期末自己株式数	2023年3月期1Q	123,618 株	2022年3月期	172,680 株
期中平均株式数(四半期累計)	2023年3月期1Q	4,560,470 株	2022年3月期1Q	4,001,213 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

#### 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料3ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間 .....	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	8
(継続企業の前提に関する注記) .....	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	8
(セグメント情報等) .....	8
3. 補足情報 .....	9
受注及び販売の状況 .....	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、各国において新型コロナウイルス感染症からの行動制限緩和による経済活動の正常化が進む一方で、ウクライナ情勢の緊迫化によるロシアへの経済制裁の強化や、中国での「ゼロコロナ政策」の影響がサプライチェーンに混乱を与えたことなどにより、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

わが国経済におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響が残るなか、原材料価格の高騰による物価の上昇や半導体・電子部品の供給不足に加え、国際情勢の緊迫化がもたらす地政学的リスクの顕在化等により、先行きの不透明感は広がっております。

このような状況の中で当社グループは、今期を初年度とする新中期経営計画「“創” lution 2025 GRIT & Adjust」を策定し、「研削で価値を創造するソリューションカンパニーへ」をビジョンとして掲げ、2025年3月期の売上高500億円、営業利益60億円の目標達成に向けスタートいたしました。

その結果、当第1四半期連結累計期間における連結売上高は10,070百万円（前年同期比26.6%増）、営業利益は1,080百万円（前年同期比138.5%増）、経常利益は1,154百万円（前年同期比135.2%増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は836百万円（前年同期比277.1%増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりです。

#### ①工作機械事業

国内市場におきましては、好調な半導体業界や設備補助金などの経済政策を背景に工作機械需要は引き続き高まっております。受注につきましては、工作機械業界、金型業界向けの大型平面研削盤や汎用平面研削盤、半導体業界向けのロータリー研削盤などを中心として好調に推移しております。売上につきましても、半導体業界や金型業界向けに大型平面研削盤の販売があり、前年同期を上回りました。

海外市場におきましては、米国では金型業界、セラミックス業界向けの需要が引き続き増加しております。受注は好調であった前年同期を下回ったものの、売上につきましては堅調に推移しております。欧州ではドイツやイタリアを中心に円筒研削盤の需要が増加するなど、受注・売上共に好調を維持しております。中国では長期にわたるロックダウンや移動制限などの規制強化により、設備投資需要が低下したため、受注は前年同期より減少しましたが、売上につきましては半導体業界向けに大型平面研削盤の販売があり前年同期を上回りました。東南アジアにおいては、行動制限緩和により設備投資意欲は回復基調にあります。受注は前年同期に届きませんでしたでしたが、売上は上回ることができました。

以上の結果、売上高は6,912百万円（前年同期比27.4%増）、セグメント利益（営業利益）は429百万円（前年同期比404.9%増）となりました。

#### ②半導体関連装置事業

半導体市場におきましては、企業のデジタル化の促進、5Gスマートフォンの高機能化によってパソコン、データセンター関連向けの半導体デバイスの需要が引き続き高まっております。

このような状況の中で当社グループは、ポリッシュ装置やラップ盤の拡販に向けて、ウェーハ業界向けの次世代機種の開発やカスタマーサポート体制の強化などの諸施策を進め、シェアの維持・拡大に努めてまいりました。その結果、受注につきましては、半導体業界の設備投資需要が高水準を維持したことにより、国内、東アジアの複数の取引先から半導体製造装置の受注を獲得するなど、前年同期より増加いたしました。売上につきましても、旺盛な半導体需要が寄与し、東アジア向けにウェーハ生産用のファイナルポリッシャーや液晶用ガラスマスク加工装置の販売をするなど、前年同期を上回りました。

以上の結果、売上高は3,158百万円（前年同期比25.0%増）、セグメント利益（営業利益）は917百万円（前年同期比53.0%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して2,066百万円増加し、49,574百万円となりました。主な要因は、受取手形、売掛金及び契約資産が985百万円、有価証券が1,500百万円減少した一方で、現金及び預金が2,152百万円、棚卸資産が2,003百万円増加したことによるものであります。

当第1四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して661百万円増加し、27,838百万円となりました。主な要因は、短期借入金が444百万円増加したことによるものであります。

また、純資産は、前連結会計年度末と比較して1,405百万円増加し、21,736百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上836百万円、配当金の支払い363百万円により472百万円増加したこと、及び為替換算調整勘定が739百万円増加したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の42.8%から43.8%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績につきましては、2022年5月12日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	7,333	9,485
受取手形、売掛金及び契約資産	8,114	7,129
有価証券	5,000	3,500
商品及び製品	4,553	5,066
仕掛品	6,331	7,365
原材料及び貯蔵品	3,418	3,874
その他	723	428
貸倒引当金	△131	△140
流動資産合計	35,343	36,710
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,454	3,791
機械装置及び運搬具(純額)	2,846	2,849
その他(純額)	3,878	4,109
有形固定資産合計	10,179	10,750
無形固定資産	158	218
投資その他の資産		
投資有価証券	255	252
退職給付に係る資産	980	997
その他	608	662
貸倒引当金	△17	△17
投資その他の資産合計	1,826	1,895
固定資産合計	12,164	12,864
資産合計	47,507	49,574
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,552	3,595
電子記録債務	2,893	2,979
短期借入金	3,040	3,484
1年内償還予定の社債	6	6
1年内返済予定の長期借入金	512	662
未払法人税等	687	412
契約負債	11,183	11,274
賞与引当金	481	310
製品保証引当金	45	43
その他	2,090	2,633
流動負債合計	24,493	25,402
固定負債		
社債	24	24
長期借入金	765	503
退職給付に係る負債	965	998
資産除去債務	119	119
その他	809	790
固定負債合計	2,683	2,435
負債合計	27,176	27,838

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	4,880	4,880
資本剰余金	140	134
利益剰余金	15,321	15,793
自己株式	△743	△532
株主資本合計	19,598	20,276
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3	1
為替換算調整勘定	436	1,176
退職給付に係る調整累計額	282	275
その他の包括利益累計額合計	723	1,453
新株予約権	9	6
純資産合計	20,331	21,736
負債純資産合計	47,507	49,574

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
売上高	7,954	10,070
売上原価	5,716	6,822
売上総利益	2,237	3,248
販売費及び一般管理費	1,784	2,168
営業利益	452	1,080
営業外収益		
受取利息	1	3
受取配当金	0	1
助成金収入	9	2
物品売却益	11	16
為替差益	41	97
その他	12	9
営業外収益合計	76	131
営業外費用		
支払利息	28	21
支払手数料	2	4
控除対象外消費税等	—	25
その他	6	5
営業外費用合計	38	56
経常利益	490	1,154
税金等調整前四半期純利益	490	1,154
法人税等	269	318
四半期純利益	221	836
親会社株主に帰属する四半期純利益	221	836



(四半期連結包括利益計算書)  
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
四半期純利益	221	836
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△3	△2
為替換算調整勘定	△93	739
退職給付に係る調整額	△5	△6
その他の包括利益合計	△103	730
四半期包括利益	118	1,566
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	118	1,566

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間（自2021年4月1日至2021年6月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	工作機械	半導体 関連装置	計		
売上高					
外部顧客への売上高	5,427	2,526	7,954	—	7,954
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	5,427	2,526	7,954	—	7,954
セグメント利益	85	599	684	△231	452

(注) 1. セグメント利益の調整額△231百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間（自2022年4月1日至2022年6月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	工作機械	半導体 関連装置	計		
売上高					
外部顧客への売上高	6,912	3,158	10,070	—	10,070
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	6,912	3,158	10,070	—	10,070
セグメント利益	429	917	1,346	△266	1,080

(注) 1. セグメント利益の調整額△266百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 補足情報

受注及び販売の状況

(1) 受注状況

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同期比 (%)
工作機械	8,661	105.5	19,161	158.0
半導体関連装置	7,600	172.0	38,659	260.2
合計	16,262	128.8	57,821	214.2

(2) 販売実績

セグメントの名称	販売高 (百万円)	前年同期比 (%)
工作機械	6,912	127.4
半導体関連装置	3,158	125.0
合計	10,070	126.6